



2019 6th International Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration

## 2019 6th International Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration LTB-3D 2019

第6回 3D集積化低温接合ワークショップLTB-3D 2019

主催

日本学術振興会産学協力委員会JSPS191委員会

May 21-25, 2019

Kanazawa, Ishikawa-prefecture, Japan

<http://www.jsps191.org/ltb3d-2019/>



Welcome Reception (21st Century Museum of Contemporary Art) May 21.

General session (Ishikawa-Prefecture Noh-Theater) May 22-24.

Excursion (Shirakawa Village, a World Cultural Heritage) May 25.

今回で6回目となる「常温接合」に焦点を絞った国際会議です。日本学術振興会産学協力委員会JSPS191委員会の主催で、米国ECS-SWB、欧州のWaferBond国際会議と姉妹関係を結んでいます。常温接合は、SAWデバイス用ウエハ貼り合わせ、半導体3D積層、CMOSイメージセンサ、光学素子、フォトニクス、さらにディスプレイの封止や太陽電池の積層、パワーモジュールなどへの適用が進められており、ここ数年、量産に適用される例も増えてきました。ワークショップでは、常温接合に関する原理的・基礎的な問題から量産への適用に至る幅広い課題を扱い、常温接合技術の現状や欧米の関連の研究開発の最新の動向を把握することができます。シングルトラックの3日間のコンファレンスですので、49件の講演+43件のポスター&ショートプレゼン(うち海外からの発表が44件)をもれなく聞くことができます。前日は金沢21世紀美術館でのウェルカムレセプション、1日目の夜には金沢城(石川門内五十軒長屋)を貸し切ったのレセプション、恒例となったフラのチュートリアル(?)と和太鼓などが企画されています。セッション講演は県立能楽堂初の試みとして、能舞台の上で行われます。ぜひご参加をご検討ください。

### Keynote & Invited Speakers:

**Surface Activated Bonding:** Tadatomo Suga, Meisei Univ., Japan

**Die to wafer direct bonding:** Frank Fournel, CEA-LETI, France

**Panel Level Packaging:** Tanja Braun, Fraunhofer IZM, Germany

**Non-Destructive Characterization:** Gregorich, Carl Zeiss SMT, USA

**Bioinspired Technical Materials:** Thomas Speck, Univ. Freiburg, Germany

**Flexible Sensors:** Jamal Deen, McMaster Univ, Canada

**Hybrid Bonding Integration:** Stephane Moreau, Univ. Grenoble Alpes, France

**GaN-Si Bonding,** Xinhua Wang, IME, CAS, China

**Silver Sintering for Bonding:** Guo-Quan Lu, Virginia Tech, USA

**Wafer Bonding For Power Devices,** Lea Di Cioccio, Univ. Grenoble Alpes, France

**Hybrid Low Temp. Solder/High-Sn Solder Joints:** Yaohui Fan, Purdue Univ., USA

**Point-of-care Immune Biosensing:** Younggeun Park, Univ. of Michigan, USA

**Wafer Bonding Technology:** Ionut Radu, SOITEC, France

**Integration of Two-Dimensional Materials:** Matiar Howlader, McMaster Univ., Canada

**Cu/Sn Joint:** Wei-Ping Dow, National Chung Hsing Univ., Taiwan

**Low-temperature Cu Ddirect Bonding:** Chih Chen, National Chiao Tung Univ., Taiwan

